证券代码：603773　　证券简称：沃格光电　　公告编号：2024-012

# 江西沃格光电股份有限公司
# 关于全资子公司继续投资建设
# 年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 投资项目名称：年产 100 万平米芯片板级封装载板项目
- 项目公司：江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北通格微电路科技有限公司（以下简称“湖北通格微”）
- 项目建设内容：本项目由湖北通格微公司作为实施主体，通过新建厂房 69,120.00 ㎡，购置一批先进设备，建设玻璃基芯片板级封装载板自动化生产产线，形成具备规模效应的封装载板产能，项目建设期为 24 个月。本项目实施建成后，将实现年产 100 万平米玻璃基芯片板级封装载板产能。
- 投资金额：项目总投资金额预计为人民币 121,564.23 万元，其中建设投资 86,021.23 万元，铺底流动资金 35,543.00 万元。截至目前，该项目已投入资金为 11,784.55 万元，该项目后续所需投资金额拟为 109,779.68 万元，拟由公司全资子公司湖北通格微继续投资建设。
- 本次项目投资未构成关联交易，不属于重大资产重组，本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议。
- 相关风险提示：本次对外投资符合公司业务发展需要及集团公司战略发展方向，项目实施过程中可能面临宏观经济周期、行业政策、原材料价格波动、安全生产、项目管理等风险。公司将积极主动关注宏观经济环境和行业政策调整变化，实施有效的内部控制和风险防范机制，确保本项目的顺利开展。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 一、 对外投资概述

### （一） 对外投资的基本情况

为进一步实现公司业务及产品化转型，充分利用现有 TGV 核心技术优势，积极布局玻璃基半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域，以进一步丰富公司的产品体系，优化产品结构，同时推动半导体封装材料以及封装技术的迭代升级。公司与湖北天门高新投资开发集团有限公司于 2022 年 6 月 17 日共同出资设立湖北通格微公司，用于投资建设“年产 100 万平米芯片板级封装载板项目”。详见公司于 2022 年 6 月 21 日于上海证券交易所网站披露的《江西沃格光电股份有限公司关于与湖北天门高新投资开发集团有限公司共同出资设立合资公司及累计对外投资的公告》（公告编号：2022-068）。

鉴于公司已于近期收购完成湖北天门高新投持有的湖北通格微 70%股权，并已办理完股权转让交割相关事项，截至目前湖北通格微已由公司参股公司变更为公司全资子公司，其作为“年产 100 万平米芯片板级封装载板项目”的实施主体，该项目总投资金额预计为人民币 121,564.23 万元，其中建设投资 86,021.23 万元，铺底流动资金 35,543.00 万元。截至目前，该项目已投入资金为 11,784.55 万元。该项目后续所需投资金额拟为 109,779.68 万元。

湖北通格微作为公司全资子公司后续对该项目的继续投入拟全额纳入上市公司合并层面。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，上述项目后续建设投入达到公司董事会和股东大会审议标准。

### （二） 董事会审议情况

2024 年 3 月 4 日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目的议案》，同意全资子公司湖北通格微继续投资建设年产 100 万平米芯片板级封装载板项目。本次议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。

### （三） 其他

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、 项目公司基本情况

公司名称：湖北通格微电路科技有限公司

统一社会信用代码：91429006MABQHL4U1U

成立时间：2022 年 06 月 17 日

注册地址：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路 317 号）

法定代表人：刘松林

注册资本：12000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：沃格光电持有 100%股权。

主要财务数据：

单位：人民币 万元

| 项目名称 | 2023 年 12 月 31 日/2023 年 | 2022 年 12 月 31 日/2022 年 |
|---|---|---|
| 总资产 | 13,020.68 | 3,506.32 |
| 负债总额 | 1,607.04 | 96.90 |
| 净资产 | 11,413.64 | 3,409.42 |
| 营业收入 | 413.09 | 48.00 |
| 利润总额 | -395.79 | -190.58 |
| 净利润 | -395.79 | -190.58 |

上述财务数据已经天健会计师事务所（具有从事证券、期货业务资格）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## 三、 投资标的基本情况

项目名称：年产 100 万平米芯片板级封装载板项目

项目公司：湖北通格微电路科技有限公司

项目地点：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路 317 号）

投资金额：项目总投资金额预计为人民币 121,564.23 万元，其中建设投资 86,021.23 万元，铺底流动资金 35,543.00 万元。

项目建设内容：本项目通过新建厂房 69,120.00 ㎡，购置一批先进设备，建设自动化程度较高的芯片板级封装载板产线，形成具备规模效应的封装载板产能，项目建设期为 24 个月。本项目实施建成后，将实现年产 100 万平米芯片板级封装载板。

截至目前项目建设进展：截至目前该项目主体厂房已完成封顶，在进行净房装修，同时相关设备采购工作在同步进行，预计今年下半年进入一期正式量产阶段。随着相关资金的到位，将有助于项目建设进度的顺利实施和产能的顺利投放。

## 四、 项目投资的必要性与可行性

### （一）项目投资建设背景和必要性

本次项目投资以公司自主研发的 TGV 技术为基础，该技术通过叠加公司所拥有的玻璃基薄化、双面多层镀铜线路堆叠、绝缘膜材以及巨量通孔等工艺和材料开发技术能力，聚焦玻璃基在半导体先进封装载板以及新一代半导体显示等领域的量产化应用。目前，在玻璃基半导体先进封装载板产品方面，公司多个项目已获得客户验证通过，并具备量产可行性；在新一代半导体显示方面，随着公司 TGV 工艺技术能力的突破，公司与国内知名企业联合发布了全球首款玻璃基 TGV Micro LED 显示屏，该产品使用公司推出的玻璃基 TGV 载板，推动了 Micro LED 显示的商用化进度，目前该产品已进入量产化推广和应用阶段。

从行业发展趋势和方向看，为持续延续摩尔定律，提升芯片性能和算力，玻璃基有望成为下一代新型半导体封装材料，其相较于硅基和有机基板材料，其在光学、电学、热稳定性、机械稳定性、成本以及降功耗等方面均有更好的表现，其在先进封装、人工智能、光通信、射频天线、微机电系统和三维集成等领域以及新型半导体显示 Micro LED 直显等高端显示领域具有广泛应用空间。据相关行业公开信息，众多国内外知名企业陆续宣布开发半导体封装玻璃基板，随着行业上下游产业链的共同推进，TGV 技术在新一代半导体先进封装和半导体显示的渗透率有望进一步提升。

### （二）项目建设的可行性

公司内部已就该项目继续投建的可行性进行论证，在该新产品新业务的人才储备、

技术储备、市场拓展、资金安排等方面已经提前进行了布局和筹划。

人才储备：公司通过现有 TGV 技术核心人员，以及产品开发、项目管理、自动化产线搭建等领域人才，组建专业团队，同时加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。

技术储备：以公司现有的玻璃基薄化、玻璃基双面多层镀铜线路堆叠、绝缘膜材以及巨量通孔等工艺和材料开发技术能力为基础，通过公司多年玻璃基镀膜以及新材料的研发实力、多学科核心技术团队及全产业链能力，以保障项目的顺利实施、投产。

市场拓展：为加快推动本次项目新建产能量产落地，打造行业知名品牌，公司引入了海内外专业市场推广人才，凭借其对于市场以及对公司产品的深刻认知，积极开拓市场。

资金安排：本次项目总投资金额预计为人民币 121,564.23 万元。截至目前，该项目已投入资金为 11,784.55 万元。该项目后续所需投资金额拟为 109,779.68 万元。资金来源为自有或自筹资金。目前该项目总产能规划的主体厂房已完成封顶，产能搭建将按照市场情况分期投入，公司已提前做好相关资金规划，并将按照项目资金实际需求分批落实到位。

## 五、 对外投资对上市公司的影响

本次投资符合公司发展战略规划和产业布局，符合行业发展趋势和方向，有利于加快推进公司玻璃基 TGV 技术在半导体先进封装以及新一代半导体显示等产品的市场推广以及产业合作进度，增强公司的核心竞争力，符合公司的长期发展战略和全体股东的利益。

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，并将按照项目资金实际需求分批落实到位，不影响公司现有主营业务的正常开展，公司将根据项目运营及市场情况，审慎规划总体经营建设方案，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。随着项目的投产运营，将提高公司市场竞争力，提升公司盈利能力。

## 六、 对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司业务发展需要及集团公司战略发展方向，项目实施过程中可能面临宏观经济周期、行业政策、原材料价格波动、安全生产、项目管理等风险。

公司将积极主动关注宏观经济环境和行业政策调整变化，实施有效的内部控制和风险防范机制，确保本项目的顺利开展。

公司将根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日